

九州半導体人材育成等コンソーシアム (第4回会合)

～ 事務局説明 ～
2024年度の取組方針 (案)

2024年2月27日
＜ 共同事務局 ＞
経済産業省 九州経済産業局
(一社) 九州半導体・デジタルイノベーション協議会



コンソーシアム活動の方向性

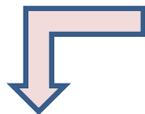
1. コンソーシアムの構成について

- ① コンソーシアムは、規約第3条に掲げる趣旨（前条の目的に賛同し、自らが保有する資源の提供等コンソーシアムに協力を惜しまない）に賛同する機関の集合体。
- ② 今後も構成機関による提案・活動、そして、一層の構成機関間の連携等によって、九州が一体となった活動を展開する。
- ③ 今後も、第3条の趣旨に賛同し参画を希望する機関があるときは、規約に基づき、参画の可否を判断する。（＝間口は綴じない）

2. コンソーシアムの活動について

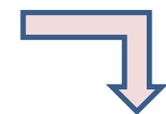
- 九州が目指す3つの姿を実現するため、構成機関が一丸となり、規約第2条に掲げる3つの取組の柱にそった活動を推進する。

実現



九州半導体人材育成等コンソーシアム
<人材育成WG、サプライチェーン強靱化WG>

実行



九州が目指す3つの姿

1. だれもが「半導体は社会基盤の主人公である」とその価値を理解している九州
2. だれもが「半導体を学ぶ楽しさ」に共感している九州
3. 半導体産業で働くことに「誇り」と「生き甲斐」を実感する九州

◆取組の3つの方向性

- ①半導体人材の育成と確保
- ②企業間取引・サプライチェーンの強化
- ③海外との産業交流促進

現状と課題

- 産業界では、必要な人材が毎年1,000人程度採用できない状態が10年間続く見通し【22FY調査】
⇒ 約3,400名/年の採用計画※1に対して、採用実績は約2,300名※2
- 半導体産業は、電気・電子に限らず理系の知識をもつ人材を幅広く必要としている【22FY調査】
- 理工系学生に半導体の魅力が浸透していない（半導体産業への就職割合は約9%）【22・23FY調査】
- 半導体産業に就職した理工系学生の約46%が、九州域外の半導体企業に就職【23FY調査】
- 理工系の新卒者を短期間で大幅に増やすことは困難（定員の壁、履修期間の壁）【構造的課題】
⇒ リスキング、ダイバーシティ推進などによる人材需給ギャップ解消可能性・実態把握が必要【23FY調査】

2024年度の主な活動（案）

※2~3つのサブWG設置（各3回程度）

① 半導体人材の育成・裾野拡大（理工系人材）

- 高専・大学等での出前講義【**拡充**】、教育コンテンツの充実・ブラッシュアップ【**継続**】
- 教員向け研修会の充実【**継続**】
- 産学・学学連携による半導体カリキュラムの拡充・相互利用（大学院を主に想定）【**新規**】

② 多様な人材活躍に向けた環境整備、横断的教育・魅力発信

- 九州の半導体産業の魅力発信（若年層や保護者対象。魅力発信コンテンツの充実）【**継続**】
- ダイバーシティ推進（女性・海外人材）、リスキングを通じた既卒・異分野・文系人材等の多様な人材活躍に向けた実態把握・環境整備【**新規**】
- 産業界やアカデミアで活躍する多様な人材のロールモデル、及びキャリアパスの収集・発信【**新規**】

③ 調査事業（上記①~②に係る実態・ニーズ把握）

調査内容の例) ダイバーシティ対応実態、大学院等での教育研究カリキュラム・実務家教員派遣に係る産学ニーズ、実態把握等

大手企業と地場企業等との取引強化（サプライチェーン強靱化WG）

現状と課題

- 2021年4月以降、公表・判明分だけで83件・4兆7,000億円超の新規投資が計画※1。台湾をはじめ国内外のメーカーやサプライヤーが九州に注目（進出）。※1) 2/27時点 九州経済産業局調べ。金額は公表済のみ
⇒ 九州域内への展開に加えて、グローバルサプライチェーンへの参入が課題
- サプライチェーンの新規参入には、価格や技術的な差別化による競争優位が不可欠だが、中小企業単独では難しく、「産学連携」「産産連携」などのアライアンスが効果的。【2022年度調査結果】
⇒ 上記実現のためには深い相互理解・信頼関係が大前提。“顔が見える関係づくり”が重要
- 国内におけるIC生産の5割超が九州で生産※2。サプライチェーンの強靱化を通じて供給責任を果たす必要。
⇒ 企業機密の取扱いに留意しつつ、災害等の非常時を想定したBCPに九州で取り組む

※2) 生産金額ベース。九州経済産業局「九州地域の鉱工業動向」

2024年度の主な活動（案）

※2~3つのサブWG設置（各3回程度）

① 企業間連携の深化と拡大

- 企業間交流会（SIIQ主催）への参加【継続】
- 九州域外との連携・マッチング支援（東北地域：レガシー製造装置のパフォーマンス維持、中国地域：デバイスメーカー・サプライヤーとのマッチング）【継続】
- BCP/物資安定供給WSの開催（九州域外との連携も視野）【拡充】

② 新たなビジネスモデル構築

- 九州の半導体産業バリューチェーン構築WSの開催（ビジョン、戦略策定）【拡充】
- 九州域内・域外、グローバルサプライチェーンへの参入支援（マッチング、ハンズオン）【新規】

③ 上記の実現に必要なネットワーク・体制整備【拡充】

海外との交流促進

九州・台湾半導体交流訪問団の派遣（2023年2月）

- 九州と台湾の半導体産業の活性化を目的に、九州の産学官を主なメンバーとする訪台団を派遣（2月9～10日、参加:28機関・41名）
- 現地で①企業間のパートナーシップ強化及び相互投資の拡大、②双方の人材育成手法の紹介・共有を目的に「九州・台湾経済交流フォーラム」を開催したほか、大学、研究機関、設計企業等を訪問。

主な訪問先・実施イベント

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 【台北市】■「九州・台湾経済交流フォーラム2023」 | ■台湾大学（重點科技研究學院） |
| 【新竹市】■工業技術研究院（ITRI） | ■国家実験研究院台湾半導体研究中心（TSRI） |
| ■陽明交通大学（電機學院） | ■CMSC（IC設計サービス企業） |

「台湾・日本半導体技術国際シンポジウム」の開催、MOU署名（2023年9月）

- 2月の訪台を機に相互の交流が深化。9月の「セミコン台湾」期間中、人材等コンソ、SIIQ、台湾側との共催による「自動車用半導体の市場ニーズとトレンド」をテーマとするシンポジウムを開催。
- 一層の関係深化と成果創出を目指し、SIIQ、九州大学、ITRI、陽明交通大学がMOUに署名。

【署名されたMOU】

- 九州半導体・デジタルイノベーション協議会 × 工業技術研究院 … 技術情報の相互提供 等
九州大学 × 陽明交通大学 × 工業技術研究院 … 研究者の技術連携、人材交流促進 等

2024年度の主な活動（2024年9月頃/2024年12月～2025年3月：いずれもイメージ）

例1）九州と台湾の半導体関連の産学官の具体的な協力深化を目的に、セミコン台湾の開催に併せて、上記2件のMOUに基づく実務的な訪台団を派遣する。【産業界主体】

例2）人材育成・共同研究分野における九州の大学と台湾の産学による関係構築・連携促進を目的に、大学関係者を中心とする幹部級の訪台団を派遣する。【教育界主体】

2024年度 活動スケジュール (イメージ)

	2024年			2025年
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
全体会合			● 第5回会合 (10月)	● 第6回会合 (3月)
人材育成WG	調査予算等獲得 (P・5月頃採択) ● 第1回WG (6月)	● 第2回WG (9月)		● 第3回WG (2月)
	サブWG (コンテンツ)	3回程度開催		
	サブWG (調査・多様性)	3回程度開催		
サプライチェーン強靱化WG	予算等獲得 (P・5月頃採択) ● 第1回WG (6月)	● 第2回WG (9月)		● 第3回WG (2月)
	BCP連携モデルWS	3回程度開催		
	バリューチェーン構築WS	3回程度開催		
	SC参入支援			
【参考】	出前講座 (前期：佐世保高専・SIIQ)	熊本工業高校、SIIQ	出前講座 (後期：佐世保高専・SIIQ)	熊本工業高校、SIIQ
・ 出前講座		教員向け企業研修会 (SIIQ、構成機関)	熊本高専、SIIQ	
・ 教員向け研修会	大分高専、大分県		大分大、SIIQ、大分県	
・ 海外交流事業		● セミコン台湾 (9月)	● 台湾EXPO (11月)	教員向け企業研修会 (SIIQ、構成機関)
	北九州高専、高校・大学・一般向け (FAIS)			